

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6126968

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
UI KUN KWON	05/18/2020
CHANG SOON PARK	05/18/2020
SEUNG KEUN YOON	05/18/2020
DAE GEUN JANG	05/18/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Street Address:	129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, GYEONGGI-DO
City:	SUWON-SI
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	16677
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16885894
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)293-7860
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	202-293-7060
Email:	tyarborough@sughrue.com, sughrue@sughrue.com
Correspondent Name:	SUGHRUE MION, PLLC
Address Line 1:	2000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
Address Line 2:	SUITE 900
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20006
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q253707
NAME OF SUBMITTER:	TODD YARBOROUGH - TEAMS
SIGNATURE:	/Todd Yarborough/
DATE SIGNED:	05/28/2020
This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	
Total Attachments: 3	

source=Q253707ExecutedDeclarationandAssignment#page1.tif

source=Q253707ExecutedDeclarationandAssignment#page2.tif

source=Q253707ExecutedDeclarationandAssignment#page3.tif

PATENT

REEL: 052783 FRAME: 0834

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언(연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이와 양도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에
명시된 출원에서 기술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

에 소재한 (양수인)는(은) 출원 및 발명의
그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권
및 이익을 획득하기를 원하므로,

이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그
양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된
출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든
특허증서와 미합중국 코드 제 35 장 제119 항에 의거한 우선권
청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개정된 파리
국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 제발행과 모든
외국에 대한 전체 권리, 소유권 및 이익을 판매, 양도 및 이전하며
그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의
특허증서를 양수인, 그 승계자 또는 그 양수인에게 발할하도록 미국
특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인이 본 발명에
대한 외국 특허증서를 신청할 수 있다는 데 동의하며, 본인(들)은
양수인의 요청할 경우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이
필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할
것입니다.

(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장
제261 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 서명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

- ☒ 정부 출원 또는
☐ 미합중국 출원 또는 PCT
국제출원 번호: _____
출원일: _____

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called
assignor(s), have invented certain improvements described in the
application identified below; and

Whereas, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. of 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,
Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right,
title, and interest in the application and invention, and to any United
States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby
acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer
to the above named assignee, its successors and assigns, the entire
right, title and interest in the application and the invention disclosed
therein for the United States of America, including all divisions, and
continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that
may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries
foreign thereto, including rights of priority under the International
Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim
priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages,
and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark
Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set
forth in the application to the assignee, its successors and assigns;
and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign
Letters Patent on the invention and I/we will execute without further
consideration all papers deemed necessary by the assignee in
connection with the United States and foreign applications when
called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence
of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- ☒ The attached application, or
☐ United States Application or PCT International
Application Number _____ filed on

The application is entitled:

APPARATUS AND METHOD FOR ESTIMATING BIO-
INFORMATION

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원을 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를
받았습니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 내용의 진위를 검토하였으며, 아울러 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 형에 규정된 바에 따라, 특히심의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특히장에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 대한민국 코드 제 18 장의 ICCI 형에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN
ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature _____

Date: _____

March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:

단독 혹은 최초 발명자의 성명

Given Name (first and middle [if any])

이름 성씨는 제외

Ui Kun

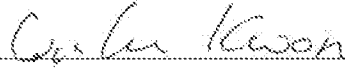
Family Name or Surname

성(姓)

KWON

Inventor's signature

발명자의 서명



Date

일자

2020.05.18

Residence:

거주지

Hwaseong-si, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소

245-1304, 213, Donganjungang-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

NAME OF SECOND INVENTOR:

두번째 발명자의 성명

Given Name (first and middle [if any])

이름 성씨는 제외

Chang Soon

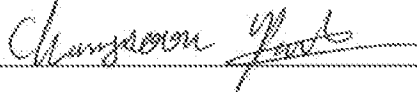
Family Name or Surname

성(姓)

PARK

Inventor's signature

발명자의 서명



Date

일자

2020.05.18

Residence:

거주지

Chungju-si, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소

277-1, Bonghyeon-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

NAME OF THIRD INVENTOR:

세번째 발명자의 성명

Given Name (first and middle [if any])

이름 성씨는 제외

Seung Keun

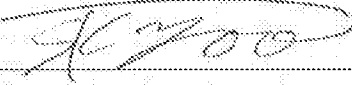
Family Name or Surname

성(姓)

YOON

Inventor's signature

발명자의 서명



Date

일자

2020.05.18

Residence:

거주지

Seoul, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소

10-1303, 200, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

NAME OF FOURTH INVENTOR:

네번째 발명자의 성명

Given Name (first and middle [if any])

이름 성씨는 제외

Dae Geun

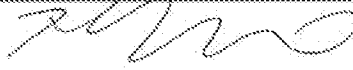
Family Name or Surname

성(姓)

JANG

Inventor's signature

발명자의 서명



Date

일자

2020.05.18

Residence:

거주지

Yongin-si, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소

101-603, 431, Gwanggyohosu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea